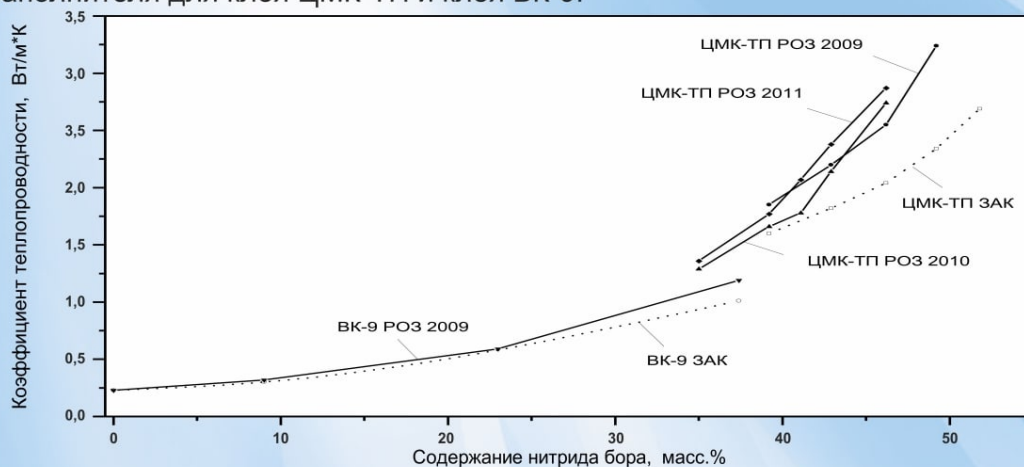


Теплопроводящие конструкционные клеи

Клеи КТК и ЦМК-ТП предназначены для соединения микросборок с отводом тепла от перегреваемых элементов, узлов микросистемной техники, микроэлектроники с целью обеспечения необходимого теплового режима работы ЭРИ, изделий микросисемной техники.

НАИМЕНОВАНИЕ СВОЙСТВ	ЦМК-ТП	КТК
Жизнеспособность при (25±10)°С, ч, н/м	3,0	4,0
Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/ м·К	1,8-2,0	1,7-1,9
Прочность на отрыв соединений АМг6 при 20°С, МПа, н/м	15,0	18,0
Прочность на сдвиг соединений АМг6 при 20°С, МПа, н/м 150°С минус 196°С	10,0	9,0
	1,8	2,5
	9,0	9,0
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, н/м		2,5·10 ¹⁴

Сравнительные кривые зависимости коэффициента теплопроводности λ от содержания теплопроводного наполнителя для клея ЦМК-ТП и клея ВК-9.

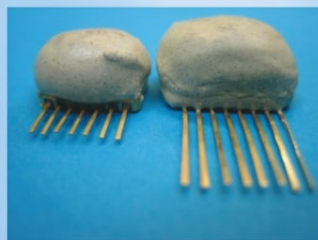


Клей КТК отличается от клея ЦМК-ТП меньшей вязкостью, что позволяет наносить его тонким слоем на микроэлементы и отверждать склейки без давления

Теплопроводящие клеи-герметики

Герметики ГЗПМ, ТПГМ, ГЗПМ-Н (ТУ 2252-4-18209440-2011) применяются для герметичного наклеивания (с отводом тепла) тонкопленочных обогревателей на приборную панель для обеспечения теплового режима работы ЭРИ.

Хорошая адгезия к полиимидной пленке, стеклотканям, алюминиевым сплавам.



Микросхема с нанесенным герметиком ГЗПМ

НАИМЕНОВАНИЕ СВОЙСТВ	ГЗПМ, ТПГМ, ГЗПМ-Н
Рабочая температура, °С	минус 60 ÷ 120 (150 кратковременно)
Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/ м·К	1,7-1,8
Удельное объемное электрическое сопротивление, ρ _v , Ом·см	≥1·10 ¹³

Для теплоотвода нагревающиеся элементы (мощные ЭРИ, электронные схемы) могут покрываться теплопроводными клеями-герметиками или заливаться этими составами в заливочном варианте с меньшим наполнением (с λ = 1,5 Вт/м·К).